

2016年10月3日

報道関係者各位

## DIC株式会社

〒103-8233 東京都中央区日本橋 3-7-20

ディーアイシービル

### DIC 高耐熱イージーピールシーラントフィルム「E1500T」を開発

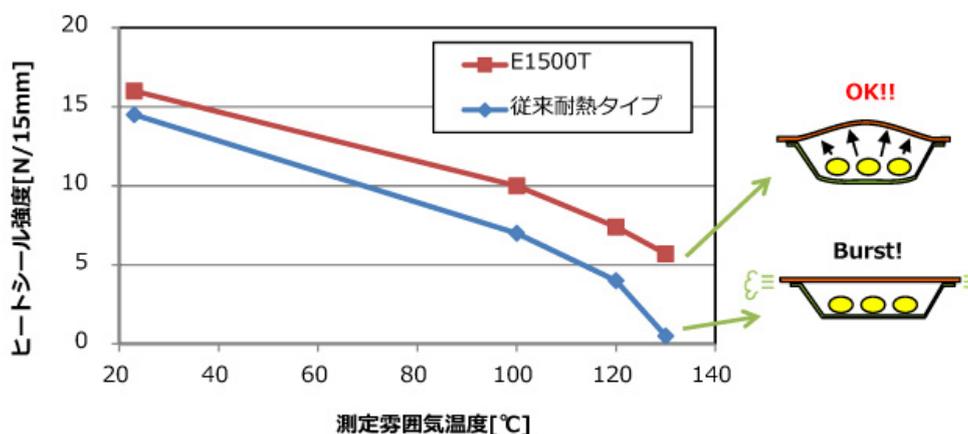
#### 業界初 130℃での加熱殺菌処理に使用できる画期的な新製品

D I C株式会社（本社：東京都中央区、社長執行役員：中西義之）は、包装用共押出多層フィルム「DIFAREN（ディファレン）シリーズ」において、業界初となる130℃での加圧加熱殺菌処理で使用可能な高耐熱性を有するイージーピールシーラントフィルム※「E1500T」を開発しました。

米飯や惣菜などの成形容器に詰められたレトルト食品は、フィルム製のフタを熱融着（ヒートシール）した後に加圧加熱殺菌処理を行います。一般的に加圧加熱殺菌は121℃程度で行われており、当社も125℃まで使用可能なPP容器用イージーピールシーラントフィルムを取り揃え、高評価を得ています。

一方、食品メーカーでは、加熱による食品の味や香りの劣化防止や殺菌の効率化を目的に、高温・短時間での処理が検討されていますが、加圧加熱殺菌時の容器内圧の上昇による破裂が課題となっていました。

このたび当社では、独自の配合技術と積層化技術を活用し、従来品の持つ易開封性を維持しながら、130℃までの加圧加熱殺菌に対応可能な、高耐熱性イージーピールシーラントフィルムの開発に成功しました。なお同開発品は、オレフィンポリマーを対象とした米国食品医薬品局（FDA）の規格「FDA CFR § 177.1520」に適合しています。



レトルト食品市場は、高齢化や単身世帯の増加を背景とした内食化や調理の簡便化ニーズの増加により、近年は年率約2%で伸長し、今後もその傾向が継続すると予想されています。

当社は、今年度よりスタートした中期経営計画「DIC108」において、インキ、接着剤を含めたパッケージ関連材料事業を成長牽引事業と位置付けています。当社は、独自技術による差別化製品を鋭意開発、拡販を進め、2020年にはイージーピールシーラントフィルムの売上高+30%を目指します。

同開発品は、10月4日（火）から始まる「2016東京国際包装展（TOKYO PACK2016）」に出展します。是非、当社ブースにお立ち寄りください。

(※) イージーピールシーラントフィルム：易開封性の熱融着する貼合用フィルム

報道機関からのお問い合わせ	コーポレートコミュニケーション部	TEL 03-6733-3033
お客様からのお問い合わせ	東京フィルム営業部	TEL 03-6733-6213
	大阪フィルム営業部	TEL 06-6252-9550